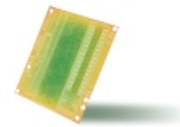


そこから、地球規模の環境貢献がはじまります。

ひとつのチップの環境負荷を知ること。



FRAM製造時のCO<sub>2</sub>排出量  
1チップあたり  
0.466 kg

半導体デバイスを生み出す企業としてできること。

表には顔を出さないけれど、なくてはならない半導体デバイス。さまざまなシステムに搭載されて、私たちの暮らしを便利にしながら、どんどん増えつづけています。そんな半導体デバイスを生み出す企業として、富士通が地球環境のためにできること。そのひとつとして、チップレベルの環境負荷を知り、それが搭載されたソリューションレベルの環境への影響まで、トータルに評価し、皆さまにきちんと明示していくことを考えました。

製造時のCO<sub>2</sub>排出量を1チップ単位で割り出しました。

半導体デバイスは、使用される原材料や化学物質も多く、製造プロセスも複雑です。そこで強誘電体メモリFRAMの製造時におけるCO<sub>2</sub>排出量を算出するために、FRAM製造工場で使用される薬品・ガス類、ウェーハの使用量、さらには製造プロセスのエネルギー消費量などを分析し、1チップあたりのCO<sub>2</sub>排出量(0.466kg)を割り出しました。私たちは、この量を少しでも減らす取り組みを進めています。



FRAMを使用したソリューションのCO<sub>2</sub>削減効果をご紹介します。

FRAM1チップあたりのCO<sub>2</sub>排出量をもとに、FRAMカードを利用したITソリューションの環境負荷を評価しました。その結果、富士通が毎年開催する富士通フォーラム会場における入退場システムでは、申込用紙の記入などが必要な従来システムと比較して、CO<sub>2</sub>排出量を14.1%削減。また、富士通ソリューションスクエアと三重工場の社員食堂で導入されたキャッシュレス決済システムでは、会計作業などが簡素化され、CO<sub>2</sub>排出量を24.5%も削減できました。



小さなチップを起点にしっかりと最後まで見届ける、この環境負荷評価手法は、将来的にはFRAMだけでなく、他のデバイス製品にも幅広く活用していく予定です。大切な地球環境をつぎの世代へと残していくために、富士通はチップレベルからエコに取り組んでいます。

チップレベルから、地球環境を考える。

Seeds for Needs . 富士通の電子デバイス

